

2024年芯片半导体行业 融资额同比减少206亿元， 上海一马当先

21家中国芯片半导体独角兽、580家公司在2024年
获得了融资



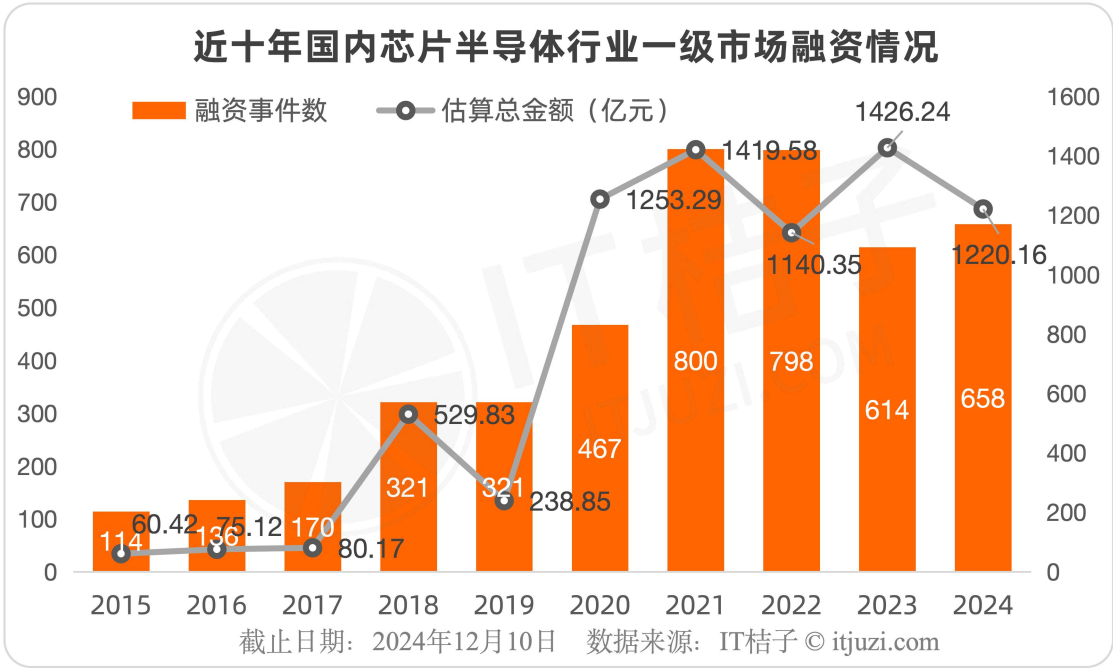
新经济创投数据服务商

在全球数字化发展的浪潮下，芯片半导体行业已成为现代科技发展的基石与引擎，深刻影响着各个领域的创新与变革。

不过，近年来国际形势变幻，贸易摩擦不断，全球芯片半导体产业链供应链遭受冲击，我国正在积极推进芯片半导体产业的自主可控进程，资本持续涌入。

2024 年国内芯片半导体行业一级市场整体呈现出需求回暖、周期向上的积极态势，虽然相较于 2023 年单笔融资规模有所缩减，市场仍较为谨慎，但融资活跃度提升。芯片半导体行业也成为 2024 年融资最为活跃的领域之一，吸引了大量资本关注和投资。

一、芯片半导体行业投融资情况



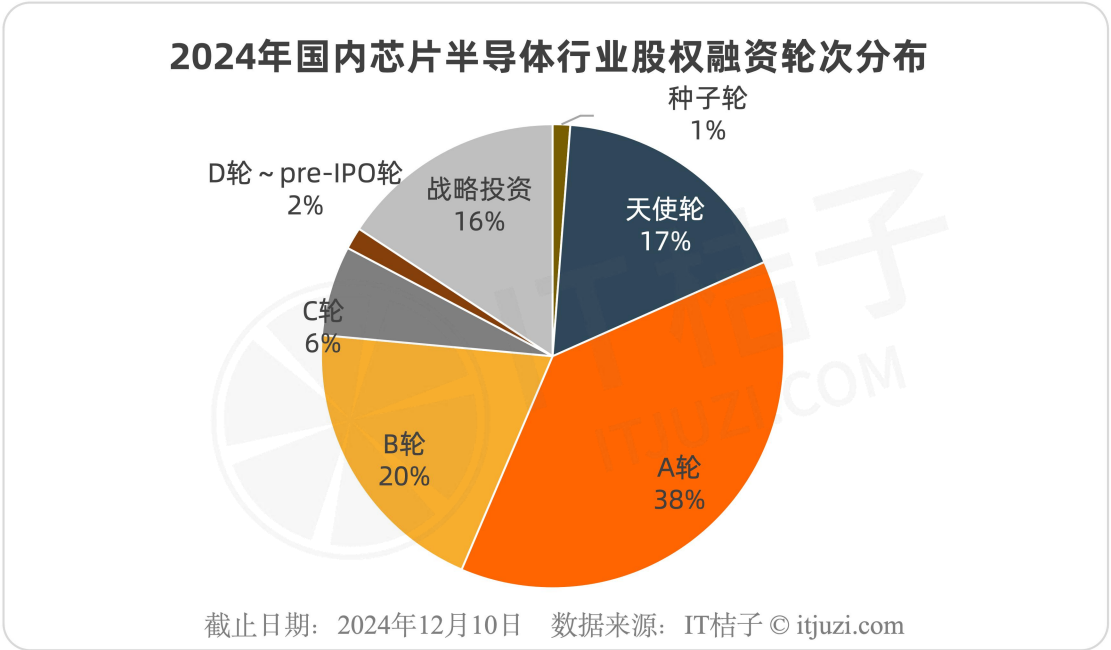
IT 桔子数据显示，2024 年国内半导体领域一级市场融资交易量为 658 起，相较于 2023 年的 614 起有所增加，增长幅度约为 7.17%；融资总金额约为 1220.16 亿元，同比下降了约 14.45%，减少了约 206 亿元。

从数据层面来看，尽管半导体行业融资事件数有所增加，市场仍然活跃，但 2024 年单笔大额融资减少、平均金额的下降导致了整体融资规模的下跌。

从行业层面来看，半导体技术不断进步，芯片制程越来越接近物理极限，技术创新的难度和成本大幅增加，开发新一代半导体技术和产品需要巨额资金投入和长时间研发周期，风险较高，使得部分投资者望而却步，进而影响资本投入金额。

同时，半导体行业具有明显的周期性波动特征。近十年，国内芯片半导体行业融资事件数呈现出先缓慢增长，后快速上升，再趋于下行、平稳的态势。

2015-2017 年，融资事件数从 114 起逐步增加到 170 起，增长较为平稳。2018-2021 年，融资事件数快速增长，融资金额也有所增长。到 2021 年融资事件 800 起，达到近十年的峰值。2023 年后至今，行业融资热度有所下滑，但整体处于高位。



从投资轮次分布来看，2024 年国内芯片半导体行业呈现出了以早期投资为主，成长期投资和战投并重的特征。

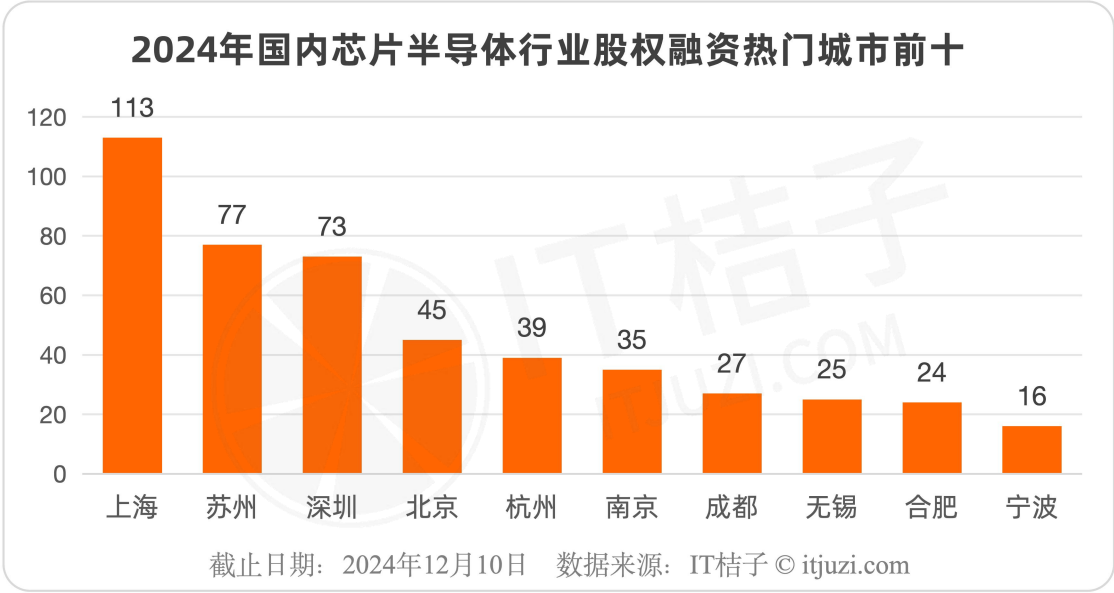
其中，A 轮融资占据了主导地位，共发生 249 起融资，占比约 38%；天使轮占比 17%，早期阶段的项目依然得到青睐，包括清软微视致力于半导体视觉领域量检测软件与装备研发，打破部分国外产品市场垄断，2022 年 1 月成立，2024 年 4 月获 A 轮融资。

B 轮融资则有 131 起，占比约 20%，表明已有不少半导体公司进入中后期融资阶段，但 C

轮及以后的比例较低,只有少数能够持续创新、保持市场领先地位并实现规模化盈利的企业,才能成功拿到 C 轮的“入场券”。比如瀚博半导体作为高端 GPU 芯片提供商,拿到了 C 轮融资,还有芯视界微电子凭借芯片级光电转换器件设计和单光子检测成像技术获 C 轮资金支持。

在 2024 年国内芯片半导体行业融资中,战略融资占比达 16%,且十亿以上融资均为战略融资。行业正处于技术迭代与格局重塑关键期,企业需战略融资整合资源、扩张市场。比如紫光展锐获多方战略投资,资金用于先进通信芯片研发,提升在 5G 及未来通信芯片领域竞争力;北京电子控股旗下集成电路制造企业“北电集成”获战略投资 200 亿人民币,用于建设 12 英寸集成电路生产线项目,带动北京形成完整产业链。

值得注意的是,半导体行业战略投资中,国资的参与率较高,占比 45.63%,包括国家集成电路产业投资基金、亦庄国投等国资机构,积极布局集成电路产业。



如图所示, 2024 年国内芯片半导体融资主要集中在长三角、珠三角和京津冀等经济发达地区, 其中上海、苏州、深圳等地的半导体产业公司获得了较高的投资关注, 每个地区的融资事件数均在 70 起以上。

这些城市大多位于中国东部沿海地区, 经济发达、科技资源丰富, 是芯片半导体行业发展的

重点区域。

上海以 113 起融资事件断层领先，这得益于上海拥有完整的半导体产业链，涵盖芯片设计、制造、封装测试、设备材料等环节。张江高科技园区作为核心载体，聚集了中芯国际、紫光展锐、华虹半导体等龙头企业，形成协同效应。同时上海推出了《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》等相关政策，明确将集成电路列为重点扶持领域。获投代表企业包括瀚博半导体和芯聆半导体。

苏州以 77 起融资事件排名全国第二，苏州本身具有雄厚的工业基础，尤其是在电子信息优势明显；加上“元禾控股”、苏州工业园区产业基金、苏高新创投等苏州本土国资平台，为半导体企业提供资金和政策倾斜。获投代表企业有异格技术和旗芯微半导体。

深圳以 73 起融资紧随其后，深圳依托华为、中兴等科技巨头，形成“硬件+芯片”联动生态，国资和民营市场化资本活跃，金融政策友好，创新氛围浓厚。获投代表企业有北极芯微和瑞识科技。

北京作为首都，半导体融资活跃度仅排名第四，是由于北京产业结构较为多元化，政策更多向人工智能、云计算等领域倾斜，半导体产业聚焦于设计环节（如昆仑芯、灵汐科技），制造与封测环节相对薄弱，北电集成的成立、融资正是在补足这一短板。

同时，成都的上榜也反映出中国芯片半导体产业正在向内陆地区拓展，区域分布更趋平衡，获投代表企业有成都超纯和成都迈科。

2024 年国内芯片半导体行业最活跃的投资方		
投资方	2024 年投资数	部分投资案例
卓源亚洲	17	晶耀芯辉、艾斯谱光电、中茵微电子
深创投	17	强华股份、芯空微电子、埃芯半导体
国家集成电路产业投资基金	10	九同方微电子、晋科硅材料、行芯科技
中金资本	10	立芯软件、思锐智能、昂宝电子
国投创业	9	中茵微电子、立芯软件、容导半导体

临芯投资	9	嘉兴恒拓微、新沥半导体、轻舟微电子
毅达资本	9	芯慧微电子、道达智能、淄博芯材
锡创投	9	云岭半导体、能芯检测、埃瑞微半导体
尚颀资本	9	积塔半导体、昆高新芯、芯联动力
中科创星	9	鲁欧智造、光引科技、屿西半导体
金浦投资	9	微针半导体、埃芯半导体、兴华芯
截止日期：2024 年 12 月 10 日 数据来源：IT 桔子 © itjuzi.com		

在 2024 年芯片半导体行业的投资市场中，卓源亚洲、深创投、国家集成电路产业投资基金等机构表现尤为活跃。

值得注意的是，国资背景的投资方在行业中占据了重要地位。深创投以 17 次的出手次数成为最活跃的投资机构，投资了强华股份、芯空微电子、埃芯半导体等企业，覆盖了从材料到设备的多条赛道，展现了地方国资对半导体产业的深度布局。

国家集成电路产业投资基金作为国家队大基金，则以 10 次出手展现了其国家级引导作用，主要集中在半导体材料、EDA 工具等关键领域。

国投创业是国家开发投资集团旗下的专业投资平台，2024 年出手 9 次投资中茵微电子、立芯软件、容导半导体等项目，聚焦核心技术产业化和商业化落地，体现了其兼具战略导向和市场化的投资特点。

锡创投作为无锡市的地方国资投资平台，通过结合地方产业规划深耕区域半导体产业，以 9 次出手推动地方半导体生态建设。

中金资本出手 10 次，凭借金融领域的资源优势积极参与行业投资，包括立芯软件、思锐智能、昂宝电子等项目，布局广泛，覆盖了从设计、制造到应用的全产业链。

VC/PE 机构在芯片半导体领域的投资更加市场化，注重前沿技术和高成长性企业的挖掘，出手次数较多，展现了其对行业的高度关注。

卓源亚洲、中科创星是 2024 年国内半导体行业最活跃的早期投资机构之一，分别出手 17 次和 9 次，投资了晶耀芯辉、艾斯谱光电、鲁欧智造、光引科技等项目，重点关注 AI 芯片、光电子等新兴领域，体现了对技术前沿的高度敏感。

临芯投资和毅达资本则更偏向于成熟技术的产业化，2024 年都出手 9 次，投资了嘉兴恒拓微、新沥半导体、芯慧微电子、道达智能等项目，覆盖了从设计到制造的多个环节，展现了稳健的投资风格。

此外，尚颀资本和中芯聚源等产业资本同样出手 9 次，通过资本纽带推动产业链上下游的协同发展，注重生态整合和技术协同。

二、2024 年获得多轮融资的半导体公司

IT 桔子数据显示，2024 年共有五百八十余家国内半导体公司获得融资，其中 67 家公司一年内披露的融资笔数在两轮以上，表现亮眼。

另有四家公司年内获得了 3 轮融资，分别是埃瑞微半导体、太初元碁、泰矽微电子和紫光同创，以下将作为案例分别介绍这四家企业的基本情况。

2024 年国内连续获得两轮以上融资的半导体公司					
公司简称	简介	成立时间	融资时间	轮次	投资方
泰矽微电子	高性能专用 MCU 芯片供应商	2019-9	2024/4/24	战略投资	博奥集团
			2024/7/8	战略投资	星宇股份
			2024/10/4	战略投资	浙江联益控股
太初元碁	智能算力系统	2019-11	2024/8/9	A+轮	金蚂投资 霜叶创投
			2024/3/18	A+轮	龙芯中科
			2024/12/2	A+轮	青创投资 上海宝山国投 信德实业
埃瑞微半导体	半导体前道量检测设备研发商	2023-7	2024/3/6	种子轮	金雨茂物 源码资本 卓源亚洲
			2024/1/5	种子轮	源码资本 锡创投-无锡金投 险峰 卓源亚洲
			2024/8/6	Pre-A 轮	卓源亚洲 金雨茂物

紫光同创	FPGA 可编程器件研发商	2013-12	2024/7/10	C+轮	北京国管
			2024/11/13	战略投资	交银投资
			2024/10/16	战略投资	联通中金 布谷天阙 立丰投资 诺瓦星云
万像电子	集成电路芯片设计及服务	2014-4	2024/7/2	B 轮	西部证券
			2024/2/21	A+轮	西高投 西交大一八九六资本 中财融商 空天院 常青资本 瑞垚
SynSense 时识科技	类脑计算及类脑芯片设计与研发	2020-3	2024/9/13	B+轮	哈勃投资(华为旗下)
			2024/8/1	B 轮	宁波通商基金 Samsung Ventures 三星
泰科天润	半导体碳化硅材料 (SiC) 器件制造商	2014-4	2024/1/3	E+轮	京铭资本 国铸资本 三山科元
			2024/7/1	战略投资	泸州老窖
瀚博半导体	高端 GPU 芯片提供商	2018-12	2024/6/14	C 轮	阿里巴巴 经纬创投 红点中国 真格基金 五源资本 耀途资本 未来资产 上海欣星多媒体
			2024/9/29	C+轮	中国互联网投资基金 国寿股权 招商局资本
驰芯半导体	物联网芯片设计企业	2020-6	2024/9/19	A+轮	昆山高新集团
			2024/11/19	A+轮	兴湘集团
寰采星	精细金属掩模版研发商	2019-3	2024/11/25	C 轮	创东方投资
			2024/7/19	B+轮	金圆集团/金圆资本
JBD 显耀显示	LED 微显示芯片研发商	2015-10	2024/12/2	B 轮	混沌投资 上海国际集团/上海科创基金
			2024/6/6	Pre-B 轮	蚂蚁集团 广发乾和 吉利汽车
后摩智能	大算力智能计算芯片	2020-11	2024/11/5	战略投资	中山金控
			2024/7/15	战略投资	中移创新产业基金
昕原半导体	新型 IDM 类型半导体企业	2019-11	2024/5/16	B+轮	中电基金 深创投 联新资本 Prosperity7 Ventures
			2024/3/13	B 轮	字节跳动
格励微	高性能混合信号集成电路设计商	2017-10	2024/3/22	C 轮	电控产投
			2024/10/24	C+轮	同创伟业 德鸿创展
芯密科技	半导体全氟密封材料与产品供应商	2021-1	2024/9/1	B 轮	IDG 资本 建信信托 睿鲸资本
			2024/5/29	战略投资	中化资本
海飞科	AI 高性能处理器芯片和软硬件全栈系统解决方案	2020-8	2024/8/28	C+轮	恒林股份
			2024/1/12	C 轮	武岳峰资本 Plug and Play 珠海高新投
成都迈科	微系统关键材料	2017-6	2024/2/19	Pre-A 轮	毅达资本

	与集成技术研发商		2024/7/30	A 轮	毅达资本 成都毅达交子环投兴华汇蓉壹号创业投资基金合伙企业
韶光芯材	光掩模材料制造企业	2003-8	2024/1/17	B 轮	宝鼎投资 基石资本 金雨茂物 嘉御资本 湖南高新创投集团 长投控股 五矿高创 瑞兴投资
			2024/8/29	B+轮	达晨财智 上海国盛集团 瑞兴投资 长飞产业基金
熙泰科技	半导体微显示的研发与制造商	2016-6	2024/2/7	A 轮	坤言资本 四川发展产业引导基金 芜湖市建投 瑞丞基金 兴众风投 眉山天府引导基金 国科京东方
			2024/6/3	A+轮	远大创投 芜湖建设投资 安泰投资
青禾晶元	先进半导体异质集成技术及方案提供商	2020-7	2024/7/8	B 轮	深创投 芯动能投资 天创资本 远致星火 正为资本 芯朋微
			2024/1/29	B+轮	中金资本 清科创投 聚源投资
篆芯半导体	高性能网络芯片研发商	2021-1	2024/2/27	A+轮	隆湫资本 君盛投资 卓源资本 华方资本 睿悦投资 广东柠盟投资
			2024/2/18	A 轮	信熹资本 金浦投资 毅岭资本 中博聚力 国海创新资本 卓源亚洲 顺为资本 华业天成 招商局资本 泰有投资 冰木清华校友种子基金 厚雪资本 柠盟投资 利河伯资本 泰实浩华资本 博深实业 锐捷网络
科默罗	射频与位置感知芯片研发商	2021-10	2024/5/14	A 轮	国科微
			2024/6/21	A+轮	灏浚投资 兰湾投资
康芯威	嵌入式存储器生产商	2018-11	2024/10/31	B 轮	昆山高新集团
			2024/1/2	A+轮	中信建投资本 东吴创投-东吴证券 卓源亚洲 华安嘉业 海越资管 博众信合
聆思智能	AIoT 智能终端 SoC 芯片研发商	2020-4	2024/1/15	A+轮	力鼎资本 山东铁路基金
			2024/10/31	B 轮	润璋创投 元禾辰坤
羲禾科技	硅基光电集成芯片设计制造商	2021-5	2024/9/14	B 轮	达晨财智 观新生元创投
			2024/5/10	A+轮	电控产投 麟毅资本
湃泊科技	工业激光芯片热沉及整体散热解决方案服务商	2022-1	2024/1/17	A 轮	晨道资本 深圳天使母基金 国发创投 超兴创投
			2024/9/5	A+轮	中芯聚源 东莞科创 大米创投
思锐智能	半导体 ALD 设备供应商	2018-1	2024/5/30	C 轮	青松资本 中金资本 中车资本 石溪资本 千帆资本 中车四方所
			2024/3/1	B 轮	尚颀资本 鼎晖投资 招商局创投 金浦投资 新鼎资本 创新工场 华控基金 青创投 海松资本 同歌创投 鑫芯创投 海澳芯科 珩创投资 上汽集团
成都超纯	半导体刻蚀器件企业	2005-8	2024/8/29	战略投资	沃衍资本 丰年资本 芯动能投资 TCL 集团 建信信托 尚颀资本 华泰紫金 基石资本 泽森清泉 南京华泰紫金新兴产业基金合伙企业（有限合伙）

			2024/4/26	B 轮	正海资本 比亚迪 鑫芯创投
捷策创	集成电路测试服务提供商	2011-4	2024/4/12	B+轮	上海共正
			2024/10/23	战略投资	致道资本
通嘉宏瑞	泛半导体行业干式真空泵装备及系统技术服务供应商	2019-7	2024/4/19	Pre-B 轮	初辉资本 达晨财智 辰峰资本 国开科创 青松资本 立丰投资
			2024/9/14	B 轮	石溪资本 燕创资本
日观芯设	集成电路电子设计自动化（EDA）	2021-4	2024/4/1	Pre-A 轮	创维集团 产研中翔
			2024/8/28	A 轮	山证投资 琢石投资
知合计算	人工智能芯片研发商	2022-10	2024/9/9	A 轮	源码资本 领航新界 云九资本 厚雪资本 临港科创 乐朴投资 上海云玖一号创业投资合伙企业 厚雪启明星河股权投资基金（合肥）合伙企业 上海临港新片区科技创新私募投资基金合伙企业
			2024/1/10	Pre-A 轮	浙大联创投资 鼎晖投资 华登国际 临港科创 联新资本 海南裕达 中益仁投资
中昊芯英	AI 芯片研发商	2020-10	2024/9/13	B+轮	艾布鲁
			2024/8/1	B 轮	浙江正方资产
本原聚能	数模混合集成电路设计服务商	2018-11	2024/6/28	A 轮	鼎量量子 兴森科技
			2024/9/6	A+轮	凤璟基金
新毅东	半导体生产线设备研发商	2014-3	2024/2/5	A+轮	比亚迪 惠友资本
			2024/6/29	B 轮	元禾重元 龙鼎投资 亦庄国投 方正和生投资 惠山科创 莫干山高新投资 一元航天 高易创投 翔达基金
锐泰微	专注芯片研发的高新技术企业	2021-1	2024/6/18	A+轮	广汽集团
			2024/7/12	B 轮	顺禧基金 国海创新资本 安徽省国海瑞丞芯车联动创业投资基金合伙企业
光钜微电子	射频前端 BAW/FBAR 滤波器	2021-7	2024/11/13	战略投资	武汉凡谷
			2024/1/25	B 轮	长江资本 湖南高新创投集团 宁波甬商实业 湖北省铁路发展基金
艾斯谱光电	LED 智能封装服务提供商	2020-10	2024/2/19	A+轮	贵阳创投 卓源亚洲
			2024/9/13	B 轮	力合科创 卓源亚洲
泓芯半导体	半导体配件经销商	2018-7	2024/9/3	战略投资	深圳新星
			2024/5/30	战略投资	毅仁创投 嘉兴毅仁永晟股权投资合伙企业
科瑞尔	半导体封装测试设备公司	2014-8	2024/6/12	A+轮	常州高新投
			2024/11/18	战略投资	中车资本
工研拓芯	光电芯片设计研	2023-4	2024/4/19	A+轮	常熟国发创投 浩澜资本

	发商		2024/9/24	A+轮	苏州天使母基金 苏州天使创新一号投资基金合伙企业
中瑞宏芯	SiC 功率芯片与模块研发商	2021-6	2024/7/11	B 轮	德石投资
			2024/1/2	A+轮	鼎心资本 天堂硅谷 高曼控股 岭鑫资本 纳芯微 禾迈电子
晟联科	半导体芯片 IP 设计服务商	2022-9	2024/7/31	B+轮	尚颀资本 海望资本 考拉基金 钱塘产业集团 清紫泽源
			2024/4/3	B+轮	新投集团 金浦投资 海望资本 浦科投资/浦东科投
欧思微	无线 SoC 芯片研发商	2020-10	2024/8/26	Pre-A 轮	金鼎资本
			2024/1/10	Pre-A 轮	力合科创 合肥高投 咏归基金 博通集成
首传微	高速传输与通信芯片设计研发企业	2021-3	2024/6/25	B+轮	武进高新投
			2024/1/2	B 轮	武岳峰资本 中芯熙诚 清研资本
鑫跃微半导体	半导体技术研发商	2022-1	2024/7/10	Pre-A 轮	高捷资本
			2024/1/3	Pre-A 轮	武岳峰资本 新尚资本 金慧丰投资 开拓资产
微釜半导体	半导体器件专用设备制造商	2022-1	2024/9/25	A 轮	金雨茂物 山西国投
			2024/1/9	战略投资	浦科投资/浦东科投 迈为科技
新芯航途	自动驾驶芯片研发商	2023-12	2024/1/8	天使轮	尚颀资本 顺为资本 真格基金 苏州高铁新城
			2024/4/19	天使轮	苏州高铁新城 尚颀资本
冷芯半导体	半导体控温技术企业	2021-9	2024/1/18	A+轮	光谷烽火创投
			2024/4/26	B 轮	沈阳产研院 和生中德投资
向至科技	集成电路芯片及产品提供商	2023-8	2024/6/17	A 轮	深圳资本
			2024/1/26	天使轮	元禾原点 常熟国发创投 元禾控股
中车时代半导体	功率半导体研发及产业化服务商	2019-1	2024/4/26	战略投资	国家集成电路产业投资基金 中信证券 国新科创基金（国新基金） 株洲国创 成都轨交 华电集团 上汽集团 哈铁科技
			2024/3/22	战略投资	中车时代高新投资
萃锦科技	功率器件生产商	2024-1	2024/4/3	天使轮	金浦投资
			2024/1/19	种子轮	英飞尼迪 Infinity 歌斐资产 力宽投资
奕泰微电子	车载以太网芯片研发商	2022-8	2024/7/4	Pre-A 轮	基石创投 北京基石智盈创业投资中心
			2024/4/17	Pre-A 轮	中科创星 力合科创 前海鹏晨 同创共进
行云集成电路	AI 芯片的硬件形态重塑大模型计算系统	2023-8	2024/9/18	Pre-A 轮	嘉御资本 同创伟业 春华资本 Primavera 中新集团 君盛投资 清科创投
			2024/4/29	天使轮	奇绩创坛 中科创星 Z 基金-智谱 AI 聚合资本 峰瑞资本 仁爱资本 水木清华校友种子基金

格见半导体	工业级高性能实时控制器（DSP）芯片设计公司	2022-4	2024/11/25	A 轮	微禾投资 混沌投资 中车时代高新投资 稳正资产
			2024/5/19	Pre-A 轮	微禾投资 中车时代高新投资 混沌投资 鑫芯创投
铭诚微电子	中央控制处理芯片研发商	2023-2	2024/5/9	Pre-A 轮	农发重点
			2024/1/4	天使轮	振兴发展基金
创晟半导体	半导体芯片研发商	2023-7	2024/6/18	A 轮	华业天成
			2024/11/11	A+轮	科大讯飞 国元创新投资
连森电子	半导体元器件材料研产商	2021-10	2024/5/31	Pre-A 轮	TCL 集团
			2024/7/15	Pre-A 轮	厦金创新私募基金
普莱特	电镀机制造商	2024-2	2024/8/9	天使轮	复旦创新
			2024/10/12	Pre-A 轮	时远基金
西安德盟特	半导体器件研发商	2016-3	2024/8/8	Pre-A 轮	弘斐基金
			2024/1/8	天使轮	科控协同投资 西交一八九六资本
博思芯宇	人工智能算力芯片	2024-7	2024/11/14	天使轮	华睿投资 启迪之星
			2024/8/28	天使轮	-
华芯智能	半导体晶圆级封装设备服务商	2021-7	2024/4/18	A 轮	金海通
			2024/9/17	A+轮	霞印投资
镓楠半导体	氮化镓半导体材料生产商	2023-7	2024/9/27	天使轮	晨晖创投
			2024/11/1	Pre-A 轮	顺为资本
赢晟新材	芯片制造用纳米材料研发生产商	2021-9	2024/9/29	Pre-A 轮	涵商资本
			2024/1/8	天使轮	宁波通商基金 宁波天使投资引导基金 浙大创投
捷扬微	测距定位和无线连接芯片研发商	2020-10	2024/6/24	A+轮	水木清华校友种子基金
			2024/11/22	B 轮	毅达资本
光羽芯辰	端侧大模型芯片研发商	2024-7	2024/11/13	天使轮	科大讯飞
			2024/7/26	种子轮	兆易创新 燧原科技
叁砖科技	MOCVD 设备研发商	2024-3	2024/8/19	天使轮	久科投资
			2024/5/22	种子轮	深圳市银杏道投资 成都银幸道金煌企业管理合伙企业
截止日期：2024 年 12 月 10 日 数据来源：IT 桔子 © itjuzi.com					

埃瑞微半导体：芯片制造的“质检专家”

埃瑞微半导体（AirySemi）专注于研发和生产集成电路芯片前道量检测设备。通俗来说，就是为芯片制造提供“眼睛”和“尺子”，帮助芯片工厂在生产过程中检测和测量芯片的质量和精度。

公司核心团队实力雄厚，创始人及 CEO 段洪伟来自美国 KLA 上海研发中心，CTO 盖洪峰博士为清华大学精密仪器系博士，曾任中国科学院微电子所研究员，核心团队拥有超过 20 年以上的研发、量产经验，是亚洲为数不多的成建制套刻设备团队。

埃瑞微半导体于 2023 年 7 月成立，在 2024 年内就连续融 3 轮：

- 1 月，该公司获得了源码资本、险峰长青、卓源亚洲、锡创投、中小企业发展基金等多家知名投资机构的数千万人民币种子轮投资。
- 3 月，又顺利完成由金雨茂物领投，源码资本、卓源亚洲等老股东跟投的种子+轮融资，融资金额未透露。
- 8 月，卓源亚洲和金雨茂物再次联合追加投资 Pre-A 轮融资，金额未透露。

2024 年 12 月，埃瑞微半导体前道套刻设备总部项目正式在江苏无锡高新区签约，下一步将加快样机研发进度。

太初元碁：国家超算孵化的 AI 芯片企业

太初元碁是国家超级计算无锡中心孵化成立的科研成果产业化公司，致力于国产高性能人工智能芯片的设计研发与国产软件生态的建设，主要面向政府和企业客户，提供完善丰富的芯片产品与系统软件解决方案。

太初元碁的创始团队成员主要来自清华大学、国家超级计算无锡中心以及无锡江南计算技术研究所等知名机构。董事长杨广文，清华大学计算机科学与技术系教授，担任国家“863”计划、国家重点研发专项等项目首席科学家，同时也是国家超级计算无锡中心主任。

在融资方面，

- 太初元基于 2021 年 9 月完成天使轮融资，金额达 1.5 亿人民币，招商局资本投资。
- 2023 年 10 月完成 A 轮融资，虽然具体金额暂未公开，但背后的投资方阵容强大，无锡创投、中科图灵、无锡产业集团、盐城国智以及惠山科创等业内知名机构纷纷助力。
- 2024 年 3 月，太初元完成了 A+轮融资，融资金额未透露，投资方为龙芯中科。
- 同年 8 月 9 日，又完成数亿人民币的 A+轮融资，金蚂投资和霜叶创投联手入局。
- 2024 年 12 月，太初元完成 A+轮融资，青创投资、上海宝山国投和信德实业加入投资方阵营。

太初元基于 2024 年推出了“智算中心全流程解决方案”，让高性能计算和人工智能算力能够普及化、低成本化。

泰矽微电子：车规级 MCU 芯片的国产先锋

泰矽微电子是一家高性能专用 MCU 芯片供应商，专注于各类高性能模数混合芯片研发。

致力于发展成为平台型芯片企业，打造各类高可靠性模数混合车规专用芯片。

创始人兼 CEO 熊海峰毕业于哈尔滨工业大学和复旦大学，拥有 18 年半导体技术及业务管理经验，曾任职于多家国际知名公司。联合创始人陈清华毕业于清华大学和美国 Texas A&M 大学，曾就职于多家顶尖高科技公司。

泰矽微电子自 2019 年成立以来，在融资道路上稳步前行。

- 2019 年 12 月，公司获得普华资本数千万人民币的天使轮融资。
- 2020 年 12 月，获得数千万人民币 Pre-A 轮融资，张江集团和襄创创业投资。
- 2021 年 5 月，A 轮数千万人民币融资，资方为海松资本、祥御资本和襄创创业。
- 2022 年 1 月，A+轮融资迎来重大突破，武岳峰资本、冯源投资、海松资本和芯域行联合投资 3 亿人民币。

- 2023 年 9 月、2024 年 4 月和 2024 年 7 月，公布了三笔战略投资，星宇股份、博奥集团等投资方投入数千万人民币以上。

- 2024 年 10 月，浙江联益控股的千万级人民币战略投资进一步为公司提供资金支持。

2024 年 11 月，泰矽微发布了超高集成度车规触控芯片 TCAE10，官方宣称这是目前全球唯一可同时实现超高集成度和超高触控性能的车规触控单芯片解决方案。

紫光同创：FPGA 芯片的国产创新者

紫光同创是紫光集团旗下专注于现场可编程门阵列（FPGA）可编程器件研发的企业，专注于研发和生产高性能、低功耗的 FPGA 和 CPLD 芯片，广泛应用于通信、工业控制、图像处理、消费电子等领域。

紫光同创成立于 2013 年，拥有 800 多名员工，其中 80% 是研发人员。紫光同创早期的 A 轮融资中，紫光集团有限公司作为投资方参与其中。

- 2021 年公司拿到了 3000 万元的 B 轮融资，投资方包括闻名投资、深创投等多家机构。
- 2022 年和 2023 年的 C 轮及 C+轮融资均为 5000 万元，投资方有高瓴创投、深创投、金沙江联合资本等。
- 进入 2024 年，7 月的 C+轮融资 5000 万元来自北京国管，以及 10 月和 11 月的战略投资各 10000 万元，分别来自联通中金等机构和交银投资。

2024 年，紫光同创实现了国产高端 FPGA 芯片的量产突破，FPGA 芯片在性能和功耗上已经接近国际巨头（如赛灵思、英特尔）的产品。

三、芯片半导体独角兽再融资情况

IT 桔子数据显示，截至 2024 年 12 月，中国当前的芯片半导体产业独角兽有 50 家。其中，估值超过 100 亿美元的有长鑫存储、长江存储、上海超硅半导体、紫光展锐，共 4 家；有 37 家企业估值在 10 亿-30 亿美元之间，占比 74%。

从初次上榜时间来看，几乎所有芯片半导体独角兽均为 2018 年之后成为独角兽；2020、2021、2022 年三年间，中国每年平均有 11 家芯片半导体企业成为新晋独角兽，上榜数量相对较多；2023、2024 年，这两年的新增数据均为 7 家。

这些芯片独角兽公司主要分布在北京、上海、江苏、安徽、湖北等地，其中上海以 13 家居首，北京有 9 家。

2024 年获得融资的芯片半导体行业独角兽			
公司简称	2024 年融资金额	*最新估值（亿美元）	上榜时间
中车时代半导体	49.58 亿人民币	29.96	2024 年
瀚博半导体	未透露	16.15	2021 年
熙泰科技	未透露	15.38	2024 年
JBD 显耀显示	未透露	14.62	2024 年
长鑫存储	108 亿人民币	232	2020 年
上海超硅半导体	未透露	230.77	2020 年
紫光展锐	40 亿人民币	113.85	2020 年
积塔半导体	未透露	92.31	2021 年
昆仑芯	数亿人民币	41.54	2021 年
天数智芯	未透露	33.85	2021 年
北电集成	200 亿人民币	30.77	2024 年
沐曦	未透露	20	2022 年

芯驰科技	10 亿人民币	20	2022 年
合肥皖芯	95.5 亿人民币	14.77	2024 年
云豹智能	未透露	14.62	2022 年
东方晶源	未透露	13.85	2022 年
思朗科技	数亿人民币	13.85	2022 年
新芯股份	数十亿人民币	13.04	2024 年
芯擎科技	数亿人民币	12.62	2022 年
象帝先计算	数亿人民币	12.31	2024 年
星思半导体	5 亿人民币	12.31	2023 年
注：*估值仅供参考 截止日期：2024 年 12 月 10 日 数据来源：IT 桔子 © itjuzi.com			

根据 IT 桔子数据，2024 年有 21 家芯片独角兽公司获得了新融资，占芯片行业独角兽公司数量的 42%，表明芯片半导体独角兽的融资在当下颇为活跃。其中有 2 家公司获得了百亿以上的融资，北电集成和长鑫存储分别获得了 200 亿人民币和 108.00 亿人民币的战略投资。瀚博半导体在 2021 年完成了 16 亿人民币的 B 轮和 B+轮连续融资，此次融资后，瀚博半导体已经步入独角兽行列。2024 年，瀚博半导体再次吸引了市场的关注，获得了 C 轮、C+轮融资，资方包括阿里巴巴、经纬创投等知名投资方。

JBD 显耀显示也在 2024 年完成了数亿元人民币的 Pre-B 轮融资，由蚂蚁集团领投，吉利资本跟投，老股东继续加码，本轮融资完成后，标志着 JBD 正式跻身独角兽行列。此外，中车时代半导体在 2024 年完成了增资引入多家战略投资者的项目，此次融资后，公司的估值超过 200 亿人民币，成为湖南估值最高的独角兽企业。

从整体市场来看，全球芯片半导体市场增长显著，不同地区的表现存在差异。AI 技术成为推动行业发展的关键力量，其在各个领域的广泛应用带来了新的机遇与挑战。

然而，行业仍面临一些挑战，如技术创新、供应链风险等。

展望未来，芯片半导体行业的发展前景依然广阔。AI 将继续拉动需求，自主创新的重要性愈发凸显。各企业需在技术创新和市场拓展上持续发力，以应对全球市场的复杂变化。

同时，随着消费电子、汽车电子、物联网等下游市场的不断发展，以及全球产能向中国大陆转移等趋势，国内半导体企业有望迎来更多的发展机遇。



关注 IT 桔子账号，回复“2024 热门行业赛道”，查看包含人工智能、人形机器人、生物制药、芯片半导体、新能源、新材料等行业/赛道的投融资报告。

关于本报告

版权声明：

本报告期内所有图表、文字以及融资数据资料，版权均属于北京岁月桔子科技有限公司所有，任何媒体、网站或个人未经本单位协议授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发布、发表。已经本单位协议授权的媒体、网站、在下载使用时必须注明“来源：IT 桔子”，违者本单位将依法追究责任。

本报告不构成任何投资建议。

IT 桔子是一家新经济创业投资数据库公司，致力于收集一级市场投融资交易事件，及相关企业、人物、新闻等商业信息，形成结构化数据平台。IT 桔子成立于 2013 年，已经过 4 轮融资，并于 2019 年被华兴资本战略投资。

IT 桔子致力于通过信息和数据的生产、聚合、挖掘、加工、处理，帮助目标用户和客户节约时间和金钱、提高效率，以辅助其各类商业行为，包括风险投资、收购、竞争情报、数据定制、行业分析等。

报告出品方：IT 桔子

作者：陈睿洁

编辑：吴梅梅

排版设计：李悦

数据来源：IT 桔子@itjuzi.com

2024-2025 年

中国新经济创投数据报告

潮涌新兴，寒袭旧路

01

格局：回看十年来时路，正视变化

泡沫过去，回归理性的“阵痛”

越来越多的“+轮”背后

美元式微

创投四面开花，北上深不再独占市场

02

当下：2024 年市场的钱流向哪里？

残酷的资金分配结构，融资体量的高度集中化
有哪些赛道还在正向增长？

普通创业者是否还该期待VC式创业路径？

03

退出：市场数据与你的体感相悖了

A 股IPO 堵塞的这一年，中国公司们悄悄去
美股上市了

你说“并购交易很难”，但市场交易是增长的

04

红人：2024 风投市场的明星公司们

迅猛崛起的新晋独角兽

一年融资 4 轮、被争抢的公司

成立三年已经在筹备上市的它，默默无闻

05

主角：风投机构们的生存

到底有多少机构还在“活跃”出手？

国资！国资！国资的市场参与率还在增长

各地方国资的力量已搅动了市场格局

06

走向：中国特色社会主义 VC， 继续塑造

抛开数据，我们关注风投系统本身的运营



扫描右侧二维码获取报告